

华泰联合证券有限责任公司
关于苏州昀冢电子科技股份有限公司
2024年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：昀冢科技
保荐代表人姓名：钱亚明	联系电话：025-83387711
保荐代表人姓名：杜长庆	联系电话：025-83387762

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，对昀冢科技进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

（一）业绩下滑或亏损的风险

报告期内，公司实现营业收入29,895.02万元，实现归属于上市公司股东的净利润-2,754.92万元。公司未来业绩情况取决于宏观经济、产业政策、行业竞争态势等因素，同时也受到公司自身技术研发、产品市场推广及销售等方面进度的影响。公司将持续在产品研发、市场推广及销售等方面进行投入，如公司收入未能按计划增长，或规模效应未按预期逐步显现，则可能导致亏损进一步增加。若上述影响公司经营情况的因素发生不利变化，且公司未能采取措施积极应对，将存在业绩下滑或持续亏损的风险。

（二）核心竞争力风险

1、竞争加剧的风险

公司所处其他电子元件制造业产品众多，行业市场化程度较高，竞争较为激烈。尽管公司在精密零部件细分领域具有一定的技术、设备、客户、人才等优势，但下游产品技术迭代快，同行业竞争对手的技术水平也不断随之发展，如果公司在激烈的市场竞争中不能有效整合资源、及时开发新品、响应客户需求、提高产品质量，或者公司不能在现有产品领域及新应用领域进行有效的市场开拓，将面临市场份额下降及盈利能力下滑的风险。

2、终端用户产品升级的风险

公司产品客户定制化程度较高，受终端用户产品需求影响较大。终端用户的技术升级和产品迭代速度较快，这要求公司对于客户需求有准确、快速的把握，同时拥有较强的技术研发能力以实现产品的升级迭代，甚至先于客户需求判断行业趋势并提前进行新技术和新产品研发。如果公司在后续研发过程中对研发方向判断失误或研发进度缓慢，将面临无法满足终端用户技术升级及产品迭代需求，进而被竞争对手抢占市场份额的风险。

3、技术创新风险

随着手机光学领域终端产品不断向高像素、高响应度、小型化、轻量化方向发展，公司产品技术创新和开发的难度更高、综合性能更为全面，产品升级换代速度更快。同时，为及时响应下游客户及终端用户的产品创新需求，公司需要具备快速响应下游客户需求乃至与客户协同研发的能力，这对技术创新和开发能力提出了更高的要求。如果公司无法及时跟上行业技术升级换代的步伐，公司产品竞争力将无法持续提升，盈利能力将受到影响。

4、技术人才流失及核心技术泄密的风险

作为精密电子零部件行业的高新技术企业，高素质的人才对公司未来的发展举足轻重。基于技术团队在精密电子零部件领域突出的技术能力，公司逐步建立起业内竞争优势。虽然正常的人才流动不会对公司的研发和经营造成重大不利影响，且公司与主要技术人员签署了竞业禁止协议，但如果主要技术人员大量流失，

则可能对公司的研发和生产活动造成不利影响，进而影响公司经营业绩。

（三）经营风险

1、原材料价格波动的风险

公司生产经营采购的主要原材料包括塑料粒子、模具零件、金属、传感器及IC芯片、陶瓷薄片等。其中，塑料、金属类原材料属于大宗商品，其价格波动主要受宏观经济形势影响，传感器和IC芯片价格受下游行业周期和市场供需变化影响也较为明显。目前，公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，但若因市场供求变化、不可抗力等因素导致上述主要原材料采购价格发生大幅上升或原材料短缺，公司的盈利能力将可能受到不利影响。

2、产品市场拓展的风险

公司在汽车领域、电子陶瓷领域形成销售，但规模较小。公司虽已通过京西重工、万向精工、三井金属、东洋电装（本田系）、拿森汽车、同驭汽车、天津英创、和捷太格特等汽车系统一级龙头供应商的认证，产品供应进入向客户规模化供货阶段，但汽车类精密电子零部件产品普遍认证周期较长，可能存在产品认证周期中因终端客户战略调整导致终止认证的情况；除此之外，由于公司涉足汽车类精密电子零部件领域时间较短，在集成零部件产品上的研发及经验相对较少，因此可能面临集成汽车精密电子零部件拓展缓慢的情况。另外，随着市场需求的逐步增长，越来越多的企业参与到电子陶瓷领域，电子陶瓷行业的竞争也日剧激烈，这将伴随着产品价格波动的不确定性，如不能迅速扩大销售规模分摊成本，将会对公司未来业绩的增长造成不利影响。

公司未来在前述领域的产品销售收入存在一定的不确定性，如未来公司在汽车电子和电子陶瓷领域不能持续开拓新产品和客户，将无法在上述领域实现持续增长，进而对公司未来业绩的增长造成不利影响。

3、产品价格下降的风险

随着手机光学领域终端产品不断向高像素、高响应度、小型化、轻量化方向发展，产品更新换代相对较快、既有的产品的平均单价在同系列新产品推出后将有所下降，以及下游客户对成本控制的日益加强、行业内竞争日趋激烈带来的价

格竞争压力，使公司主要产品平均销售价格在报告期内总体降低，且不排除未来存在进一步下降的可能性，公司产品价格的下降可能对公司未来的经营业绩及财务状况造成不利影响。

4、直接客户及终端用户集中度较高的风险

公司直接客户主要为各大VCM马达厂商和CCM模组厂商，公司坚持的优质客户发展战略使得公司存在客户集中度较高的情况。目前，重点客户的销售订单对于公司的经营业绩有较大影响，如果该等客户的经营或财务状况出现不良变化，或者公司与其稳定的合作关系发生变动，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

公司产品终端用户主要为华为、小米、VIVO、OPPO、荣耀、传音等手机终端厂商，报告期内，终端用户集中度也较高。如果未来公司产品质量、创新能力不能满足终端用户需求，可能对公司未来盈利能力造成不利影响。

5、经营规模扩张引致的管理风险

报告期内，公司业务规模和资产规模快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度。公司首次公开发行股票并在科创板上市后，随着募集资金的到位和新的投资项目的实施，经营规模的进一步扩大将要求公司在战略投资、运营管理等方面根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

6、不能持续通过客户认证的风险

公司客户在引入新的供应商时，通常会进行供应商考察认证，通过认证的供应商方可进入其合格供应商资源池，客户才会与供应商建立正式商业合作关系。在首次取得客户认证后，客户会定期/不定期以稽核方式考察公司是否依然满足合格供应商的要求。因此，若公司不能持续获得重要客户的认证，将面临经营业绩增速放缓的风险。

7、MLCC项目的投资风险

公司MLCC项目具有前期资金投入大、投资周期长等特点。截至目前，由于MLCC项目处于小批量量产阶段，产生的营业收入较小，而在建工程转固导致折旧等相关费用大幅增加，以及人工、材料等运营成本增加，MLCC项目仍处于亏损状态。如果未来行业竞争加剧、行业技术发展趋势发生难以预见的变化、下游行业需求发生重大变化，存在项目效益不及预期的风险。公司MLCC项目资金来源为自有资金及自筹资金，可能存在因资金紧张带来的项目投资进度放缓的风险。如果未来MLCC项目市场开拓进展不顺利、新产品研发失败或是产能利用率未能得到有效提升等，MLCC项目存在持续亏损的风险。

（四）行业风险

公司产品应用于智能手机、通讯、汽车电子、家电、工业激光芯片和集成电路封装等领域，业务发展可能会受到下游应用市场的影响。如果未来宏观经济形势发生剧烈波动，导致下游应用市场对公司产品需求减少，或电子信息产业政策发生重大不利变化，将在一定程度上限制公司的发展速度，可能对公司业务发展造成不利影响。

（五）财务风险

1、应收账款坏账风险

截至2024年6月30日，公司应收账款净额为23,850.97万元，占资产总额的比例为14.72%。公司的主要客户为行业龙头，信用记录良好。未来随着公司经营规模的扩大，应收账款规模也会相应增长。若公司客户出现财务状况恶化、无法按期付款的情况，则将会加大公司应收账款坏账风险，从而对公司的经营稳定性、资金状况和盈利能力产生不利影响。

2、毛利率下降的风险

凭借在技术创新、生产工艺、品质控制等多方面的竞争优势，公司长期以来向下游国内外知名手机模组厂和马达厂销售高附加值的精密电子零部件产品，盈利能力较强。但随着业务规模快速拓展、产品结构调整，如未来公司不能持续对产品进行更新换代以保持主要产品的附加值和市场竞争力，则未来公司将面临毛利率下降的风险。

3、存货损失风险

未来随着公司业务规模的不断扩大，存货余额可能相应增加。较大的存货余额可能影响公司的资金周转率，也可能使得存货的报废和跌价损失增加，从而对公司经营业绩造成不利影响。

4、固定资产投资和减值风险

截至2024年6月30日，公司固定资产账面价值为72,640.08万元，占期末资产总额的比例为44.83%。

公司固定资产规模较大，受产能利用率不足、工艺技术升级、日常保养等因素的影响，存在资产减值的风险。未来，若应用市场需求的重大变化、产品转型升级发生重大变革，或出现其他更为领先的工艺技术，导致公司固定资产出现减值的风险。公司MLCC项目前期固定资产投资占比较高，相关折旧摊销金额较大，若未来MLCC市场业务开拓不及预期，MLCC业务营业收入未能按计划增长，公司的盈利空间可能存在进一步收窄的风险。上述情况将对公司的经营业绩产生较大不利影响。

5、偿债压力和流动性风险

截至本报告期末，公司的资产负债率高于同行业可比公司。未来如果公司的经营业绩和经营活动现金流量出现不利变化，可能导致公司面临较大的偿债压力和流动性风险。

（六）宏观环境风险

近年来，随着国际贸易环境的不确定性，部分国家对公司部分终端客户存在一定限制，可能会使终端客户对上游精密零部件、VCM马达和CCM光学模组等手机光学元器件的需求有所延后。若未来国际贸易环境发生重大不利变化，中美贸易摩擦进一步升级或限制规则持续，将对公司未来业绩增长造成不利影响。

三、重大违规事项

2024年3月，昀冢科技、董事长兼总经理王宾和时任财务总监于红收到了中

国证券监督管理委员会江苏监管局出具的警示函，主要是针对公司收入确认不准确、在建工程核算不准确出具的警示函，公司及相关责任人已提交整改报告，除上述之外，不存在其他受到中国证监会及其派出机构行政处罚、交易所纪律处分或采取监管措施的情形。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年1-6月，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	298,950,164.35	242,121,513.08	23.47
归属于上市公司股东的净利润	-27,549,222.02	-48,807,012.43	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,105,302.68	-52,386,197.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-53,495,212.73	-30,353,466.70	不适用
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	314,367,778.55	339,131,867.23	-7.30
总资产	1,620,479,280.99	1,614,530,195.97	0.37
主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.2296	-0.4067	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2288	-0.3979	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.7092	-0.4366	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.4292	-11.44	增加3.01个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-26.0400	-12.28	减少13.76个 百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	19.1826	16.26	增加2.92个 百分点

报告期内，公司实现营业收入29,895.02万元，较上年同期增长23.47%；归属于上市公司股东的净利润-2,754.92万元，较上年同期相比亏损减少2,125.78万元，同比收窄43.55%；基本每股收益为-0.2296元，同比收窄43.55%；稀释每股收益

为-0.2288元，同比收窄42.50%，主要原因为：（1）受益于国内智能手机终端市场需求复苏、下游客户订单增长，2024年上半年公司主营业务总体上呈现向好态势；（2）报告期内，公司优化提升资产结构，聚焦资源，收缩对半导体引线框架业务的投资，放弃对控股孙公司池州昀钇的优先增资权及实际控制权，报告期内公司非经常性损益增加5,017.84万元，导致净利润指标显著提升。

公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,510.53万元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.7092元，较上年同期相比亏损有所扩大，主要原因是MLCC业务处于成长期，伴随池州昀豕MLCC投资项目进入小批量量产阶段，在建工程转固导致折旧等相关费用大幅增加，以及人工、材料等运营成本增加所致，在报告期内对公司合并报表归属于上市公司股东的净利润影响为亏损同比增加4,862.91万元，其中MLCC项目研发费用同比增加1,847.76万元，研发费用主要构成为直接投入费用、人员费用、折旧费用等。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,349.52万元，主要系报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金及职工薪酬等增加所致。

五、核心竞争力的变化情况

1、客户资源优势

（1）客户资源

公司凭借良好的产品质量、及时的售后服务和高效的生产能力，积累了一批国际国内知名中高端摄像头模组客户和马达客户。公司与丘钛科技、舜宇光学、三星电机、磁化电子、新思考集团、TDK集团、中蓝光电、科司特、浩泽电子、三美集团等业内领先的高精密微摄像头模组以及马达企业建立长期合作关系，将公司产品应用于华为、小米、OPPO、VIVO、荣耀、传音等国内外主流品牌智能手机中。同时，公司汽车电子类产品已通过京西重工、万向精工、三井金属、东洋电装（本田系）、拿森汽车、同驭汽车、天津英创和捷太格特等汽车系统一级龙头供应商的认证，产品供应进入向客户规模化供货阶段，已获得汽车领域客户定点生产计划书，将按照客户备货计划生产和销售。电子陶瓷产品方面，公司全

资孙公司池州昀海自主开发的预制金锡陶瓷热沉产品已实现批量生产并向国内激光器一线客户实现订单交付,包括预制金锡的氮化铝、碳化硅等陶瓷热沉产品。

公司进入上述知名企业的供应链体系并形成稳定合作,是公司产品质量、订单响应速度和综合服务能力的体现。

(2) 与客户同步开发的市场领先优势

近年来,随着终端产品的迭代速度越来越快,为了缩短整个产品的研发周期,下游客户对模具和零部件供应商的同步开发能力要求也越来越高。公司多年来一直重视与下游客户的同步开发,并积累了宝贵的开发经验,一方面能够为客户的产品升级或新产品研发提供有力的支持,另一方面也能够缩短模具方案的定型时间,降低后期生产过程中修模的概率,并在成本控制上获得优势,达到与客户的双赢。

2、研发实力优势

(1) 独立开发模具的能力

独立开模能力保证了公司对产品精度的控制。模具的精度很大程度上决定了产品的精度,公司具有自主设计和组装模具的能力,子公司苏州昀石和苏州昀灏具备加工精密模具零部件的能力,主要技术骨干在本行业都有多年从业经验,苏州昀石和苏州昀灏高超的模具零部件加工水平保证了公司高精度模具零部件的供应,为公司高精度产品的生产奠定了基础。另外,苏州昀石和苏州昀灏的绝大部分模具零部件都是为公司定制化生产,这使得公司能够根据客户需求生产不同精度和复杂结构的产品。

独立开模能力使公司获得成本优势。模具是保证精密电子零部件精度的重要生产工具,且定制化程度较高,若缺少自主制模能力,公司需要承担高昂的设计成本和寻找合适生产厂家的成本。此外,公司可以从苏州昀石、苏州昀灏处稳定地获取精度较高的模具零部件。

独立开模能力使公司获得了创新优势。公司有能力快速响应客户对产品性能改变的需求,通过改变模具参数等进行可行性试验,从而及时参与到下游新产品的开发中,保持市场竞争力。

（2）改进产品工艺流程的能力

公司通过工艺参数积累、改造和研制自动化设备并实现与现有生产线之间的有序对接，来改进既有产品的生产工艺流程，搭建新型产品的生产工艺流程；公司在产品工艺流程中不断拓宽自动化技术应用范围，实现模块化生产和生产线全自动化生产和检测，进一步提高生产效率和产品品质。自动化生产线所用设备绝大部分为公司自主设计并改造。

（3）设备研制的能力

精良的设备是工艺技术创新和产品创新的基础，公司除在模具加工、注塑成型、冲压、电镀等工艺环节使用外购的标准设备外，在其他各环节投入了大量的人力和财力自主研发符合公司实际工艺需求的自动化设备。以在自动化装备中使用最为广泛的机械手为例，目前业内企业多采用气动机械手，功能单一，难调试、噪音大、换线时间长，公司出于成型工艺、双色成型工艺的特殊需求，研发出多轴机械手，采用先进的伺服电机搭配高精度的行星减速机、驱动同步带轮来实现机械手的多轴运动，运行速度快、动作灵活、调试简单、可搭配多种夹治具满足不同的生产需求。另外公司自主研发了全自动点锡贴片机、全自动绕线机、三合一排盘机、AOI检测装置、物理量检测装置、马达全自动组装线等，提高了生产效率和产品品质，是公司核心竞争力的重要组成部分。

（4）技术优势

公司通过多年的研究和实践，掌握了材料改性、模具设计和开发、各类产品工艺技术、设备研制技术等完整的生产工艺技术。通过长期的研发投入，以及多年来在精密电子零部件领域核心技术的积累，奠定了深厚的技术基础。凭借强大的研发条件和实力，公司通过了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局等相关机构的认证，获得“高新技术企业”、“江苏省民营科技企业”等荣誉资质。报告期内，获得20项专利的授权，其中发明专利8项，实用新型专利12项。知识产权成果体现了公司的设计研发水平，有助于公司不断强化产品优势，在竞争激烈的精密电子零部件市场中保持领先的行业地位，为公司未来的持续发展提供可靠助力。

3、人才优势

公司在精密模具的设计和制造、电子零部件产品的加工方面培养和储备了经验丰富的行业人才。公司历来重视研发团队的维护和培养，并持续不断地加大研发投入和完善研发体制。公司目前已经形成稳定的研发梯队，公司的核心技术人员均拥有十年以上行业内知名企业的从业经验。除了保持初创团队的稳定性外，公司还持续发展壮大技术人才队伍。

公司已建立了一支从技术研发、生产管理到市场销售各方面配置完备、各具优势、协同互补、架构稳定的管理团队，核心管理人员拥有丰富的从业经验，具备专业的技术和管理能力。通过在公司长时间的管理经验沉淀，公司管理团队具备了对发展趋势的研判能力，有助于推动公司业务全面快速发展。

公司的技术积累、成本管控、高效生产、客户维护和市场开拓等离不开研发、采购、生产和销售等各个岗位人才的付出，已经形成了成熟和稳定的业务模式。

公司通过内部的绩效激励和股权激励等多种措施，促进研发创新、提高运营效率及管理水平，从而打造国内一流的人才团队，推动公司高质量及可持续发展。

综上所述，2024年上半年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

报告期内，公司研发费用为5,734.64万元，较去年同期增长45.65%。为持续强化公司研发创新力，推动技术创新、产品迭代，增强公司市场竞争力，报告期内MLCC业务处于研发和试产阶段，导致研发投入同比大幅增长。

截至2024年6月30日，公司共计获得现行有效的专利授权261项，其中发明专利50项，实用新型211项，另获得软件著作权12项。报告期内，公司新增专利20项，其中发明专利8项，实用新型专利12项，创新成果不断丰富。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

公司于2021年8月30日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目的议案》《关于投资片式多层陶瓷电容器项目的议案》：

(1) 汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目

为满足在汽车电子和电子陶瓷领域不断增长的订单需求，公司的全资子公司池州昀豕拟投资建设汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目，项目总投资为29,953.28万元，项目分三期投资，第一期计划投资为16,823.97万元，第二期计划投资为7,377.41万元，第三期计划投资为5,751.90万元。汽车电子精密零部件项目目前处于建设装修阶段，电子陶瓷基板项目已经开始投入生产使用。

(2) 片式多层陶瓷基板项目

为了扩充公司类半导体领域中电子陶瓷的产品品类，并满足公司在MLCC领域的订单需求，提升公司市场地位，池州昀豕拟投资建设片式多层陶瓷电容器项目，项目总投资为112,435.73万元，项目分两期投资，第一期计划投资为62,479.64万元，第二期计划投资为49,956.09万元。本项目拟对建筑面积为7,953.69平方米的厂房进行装修，以达到片式多层陶瓷电容器生产所需的高标准洁净度要求；同时拟对建设面积22,826.37平方米普通洁净度及普通厂房进行装修。该项目的厂房工程、装修工程、配套设施已完成，符合片式多层陶瓷电容器产品所需的生产环境标准，生产设备已经到厂并完成安装试机工作，报告期内片式多层陶瓷电容器开始试产运行。

八、募集资金的使用情况及是否合规

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州昀豕电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]606号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金人民币288,900,000.00元，扣除发行费用40,890,319.81元(不含增值税)

后，实际募集资金净额为人民币248,009,680.19元，上述款项于2021年3月29日到账。

上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00035号《验资报告》。

（二）2024年半年度使用金额及当前余额情况

截至2024年6月30日，公司已使用募集资金248,921,316.56元,其中2021年使用222,839,738.31元，2022年使用26,081,514.51元，2023年使用2.86元，2024年上半年使用60.88元，募集资金余额为0.00元，详见下表：

单位：元

募集资金专户摘要	金额
截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额	60.85
募集资金专户资金的增加项	
(1)利息收入扣除手续费净额	0.03
募集资金专户资金的减少项	
(1)销户资金划转基本户	60.88
截至 2024 年 6 月 30 日止专户余额	0.00

截至2024年6月30日，募集资金余额为0.00元。

（三）募集资金的管理情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	储蓄方式	期末余额（元）	备注
招商银行股份有限公司 苏州园区支行	512908897010102	活期存款	-	已销户
中信银行昆山支行	8112001013900584756	活期存款	-	已销户
宁波银行股份有限公司 昆山支行	75090122000337678	活期存款	-	已销户
中国民生银行股份有限公司 苏州分行	632694669	活期存款	-	已销户
合计	/	/	0.00	

（四）募投项目先期投入及置换情况

2024年1月-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年1月-6月，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（九）节余募集资金使用情况

2024年1月-6月，公司“生产基地扩建项目”“研发中心建设项目”结项，将节余募集资金60.88元补充流动资金，并注销宁波银行股份有限公司昆山支行募集资金专户。

报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2024年1-6月，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持股及变动情况如下表：

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王宾	董事长、总经理、核心技术人员	13,183,740	13,323,220	139,480	二级市场增持
陈艳	董事会秘书、财务总监	0	5,758	5,758	二级市场增持
王清静	监事	1,595,301	1,672,561	77,260	二级市场增持
方浩	董事	2,076,340	2,110,126	33,786	二级市场增持

截至2024年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持股情况如下表：

姓名	职务	直接股东名称	直接股东持有公司股份数量	在直接股东中的持股比例	间接持有公司股份数
王宾	董事长、总经理、核心技术人员	苏州昀一	8,505,450	55.53%	4,722,651
		苏州昀二	10,206,630	85.10%	8,686,240
		苏州昀三	10,206,630	93.08%	9,500,668
		苏州昀四	9,781,290	84.06%	8,221,810
刘文柏	董事、核心技术人员	苏州昀一	8,505,450	5.25%	446,536
诸渊臻	董事、核心技术人员	苏州昀四	9,781,290	1.74%	170,106
莫凑全	董事、核心技术人员	苏州昀二	10,206,630	1.46%	148,843
方银霞	监事	苏州昀一	8,505,450	1.65%	140,340
谌龙模	核心技术人员	苏州昀一	8,505,450	3.75%	318,954

2024年1-6月公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有的公司股票未发生增减变动。

截至2024年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员股份不存在质押、冻结的情况。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

（一）2024年1-6月公司业绩持续亏损

2024年1-6月，公司实现营业收入29,895.02万元，较上年同期增长23.47%，主要系国内智能手机终端市场需求复苏、下游客户订单增长带动主营业务收入增

长所致。公司实现归属于上市公司股东的净利润-2,754.92 万元，较上年同期相比亏损减少 2,125.78 万元，同比收窄 43.55%，主要系公司收缩对半导体引线框架业务的投资，放弃对控股孙公司池州昀钇的优先增资权及实际控制权，非经常性损益增加 5,017.84 万元，导致净利润指标显著提升。

公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,510.53 万元，较上年同期相比亏损扩大 62.46%，主要是由于 MLCC 业务处于成长期，伴随池州昀冢 MLCC 投资项目进入小批量量产阶段，在建工程转固导致折旧等相关费用大幅增加，以及人工、材料等运营成本增加所致。MLCC 产品售价处于较低水平，固定资产转固后，生产成本、研发费用、财务费用处于较高水平导致亏损。报告期内，MLCC 业务对公司合并报表归属于上市公司股东的净利润影响为亏损同比增加 4,862.91 万元。

保荐机构持续关注公司业绩亏损的原因，以及相关影响因素的持续性。

公司将围绕市场开拓、产品开发、生产成本改善、工艺技术提升等方面不断改善 MLCC 业务的盈利状况：（1）报告期内，公司 MLCC 团队积极推进 IATF16949 汽车业质量管理体系认证，并计划于 2024 年底前获得相关认证资质，为公司 MLCC 业务的拓展奠定良好的基础。（2）公司将持续投入 MLCC 高容值产品的研发，预计高容值产品量产以后能够提升产品整体的销售毛利。（3）公司通过提高原材料的国产替代率，逐步降低生产成本。（4）随着生产工艺的改进以及市场销售的拓展，公司预计产能利用率不断提升。

公司 MLCC 项目具有前期资金投入大、投资周期长等特点，如果公司产品开发进度或市场拓展不及预期、未能实现降本或产能利用率的有效提升，以及未来行业竞争加剧、下游行业需求发生重大变化等，公司 MLCC 项目存在效益不达预期并且持续亏损的风险。

（二）公司招股说明书中披露的部分经营风险出现重大不利进展

公司招股说明书中披露了“公司业绩存在可能无法持续增长的风险”、“偿债压力和流动性风险”等主要经营风险。

2024年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-8,510.53万元，较上年同期相比亏损扩大62.46%，主要系公司投资的MLCC项目进入小批量量产阶段，在建工程转固导致折旧等相关费用大幅增加，以及人工、材料等运营成本增加，导致亏损增加。

2024年6月末，公司资产负债率为82.76%，资产负债率较高主要是公司发展MLCC业务持续需要资金投入，因此增加了较多的长期借款所致。公司的流动比率为0.72，速动比率为0.48，处于较低水平，主要是公司为了满足业务发展的资金需求增加了短期借款所致。

未来，保荐机构将继续督促公司采取切实措施应对外部环境和市场情况的变化，践行“提质增效重回报”行动方案，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示经营风险，切实保护投资者利益。同时，本保荐机构提请投资者特别关注相关事项带来的风险。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人:



钱亚明



杜长庆

华泰联合证券有限责任公司

2024年9月10日

